



Dual Core 3D-Kamera von Bluetechnix mit Time-of-Flight Technologie für -40 ° bis 85 °C

Extrem kleine 3D-Kamera Sentis-M100 mit Anschlüssen für LAN, RS485 und RS232

Dual Core-System ermöglicht Applikationsentwicklung direkt auf der Kamera

Die neue SentisToF-M100 baut auf einem Dual Core DSP BF561 von Analog Devices auf. Einer der Kerne wird für die Bildverarbeitung genutzt, der zweite Kern steht dem Benutzer für seine eigenen Applikationen wie Personenzählen oder Hindernisdetektion und viele weitere zur Verfügung.

LAN-Anschluss und Unterstützung für RS485- und RS232-Bus-Systeme

Die SentisToF-M100 kann direkt in vorhandene Infrastrukturen eingebunden werden. Damit erübrigt sich der Direkt-Anschluss an einen Rechner oder aber das Verlegen von Extra-Kabeln zur Nutzung der 3D-Kamera. Ideal für die Vernetzung in neueren Infrastrukturen ist der 10/100-Netzwerk-Port an der Kamera. Daneben existiert aber vor allem für ältere IT-Infrastrukturen auch eine RS232-Schnittstelle. Als dritten Anschluss kann die 3D-Kamera über eine RS485-Schnittstelle angehängt werden, wodurch sie selbst bei hohen elektromagnetischen Störfeldern problemlos arbeitet.

Echte Tiefenerkennung und Unabhängigkeit vom Umgebungslicht

Die verwendete Time-of-Flight-Technologie von PMD erlaubt die exakte Distanzmessung für jeden Pixel. Anders als bei 3D-Stereo-Aufnahmen wird keine Tiefe errechnet, sondern Pixel für Pixel bei einer Auflösung von 120 x 160 Pixeln exakt gemessen. Zusätzlich zu den Distanz-Informationen wird ein Amplitudenwert also ein Graustufenbild übertragen. Ein nettes Feature hierbei: Der Sensor hat eine integrierte, aktive IR-Beleuchtung mit 850 nm Wellenlänge und moduliertem Trägersignal. Somit kann auch bei absoluter Dunkelheit noch ein gestochen scharfes Bild übertragen werden. Ermöglicht wird dies durch eingebaute Highspeed-Infrarot-LEDs. Die zeitliche Auflösung liegt bei 40 FPS.

Einsatzgebiete und Verwendungsmöglichkeiten

Die Sentis-M100 ist unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen, weist eine geringe elektromagnetische Störanfälligkeit auf und hat eine äußerst kompakte Bauform. Durch die ToF-Technologie kann die 3D-Kamera zuverlässig reale Objekte von Spiegelungen und Schatten unterscheiden, auch bei völliger Dunkelheit. So kann die Sentis-M100 beispielsweise in Industrierobotern verbaut werden, etwa wenn es aus Sicherheitsgründen wichtig ist, dass die Maschine ihre Bewegung stoppt, wenn sie fremde Gegenstände wahrnimmt. Ein weiteres intendiertes Anwendungsgebiet sind Personen- und Fahrgastzählungen. Durch Anschluss an vorhandene Leitungen kann die Kamera bei ihrer geringen Größe beispielsweise in Straßenbahnen verbaut werden, um ein- und aussteigende Personen zu zählen. Auch eine wettergeschützte Außenmontage bei Einkaufszentren mit dem gleichen Zweck ist denkbar.

Preise und Verfügbarkeit

Die SentisToF-M100 wurde auf der Embedded World 2013 erstmals vorgestellt und ist ab Mitte April für Entwickler und in Kleinserien erhältlich. Die SentisToF-M100 hat als Industrial Version die Order-Nummer 150-3001-1 und unterstützt den Temperaturbereich von -40° bis +85° C. Bluetechnix liefert zudem ein Binary für VDSP++ und uClinux mit. Der Stückpreis beträgt 690 EUR. Weiterführende Informationen finden Sie unter <http://www.bluetechnix.com/goto/sentis-tof-m100>. Ausführliche Informationen über den verwendeten PMD-Chip finden Sie unter http://www.pmdtec.com/products_services/pmd_photonics_specs.php.

Pressekontakt

Prolog Communications GmbH

Herr Matthias Scholz-Dürrschmied
Sendlinger Straße 24
80331 München

prolog-pr.com
matthias.duerrschmied@prolog-pr.com

Firmenkontakt

Bluetechnix GmbH

Herr Daniela Hübsch
Waidhausenstr. 3/19
1140 Wien

bluetechnix.com
daniela.huebsch@bluetechnix.com

Das 2004 gegründete österreichische Unternehmen Bluetechnix GmbH bietet eine breite Produkt- und Dienstleistungspalette im Embedded Systems-Bereich an. Dabei schließt das umfangreiche Angebot alle Bereiche von der Idee über das Schaltungsdesign mit abschließender Serienreife bis hin zur EMV-Optimierung ein. Die so entstandenen drei Bereiche: Products, Solutions und Laboratories decken die Geschäftsfelder von Bluetechnix von der Herstellung vom SoM (System-on-Modules) bis hin zur kundenspezifischen Entwicklung von Embedded Systems sowie EMV-Messung und Zertifizierung im eigenen EMV-Labor und in Partnerschaft mit dem TÜV Austria ab.

Im Geschäftsfeld Products bietet Bluetechnix Entwicklungsboards, SoM sowie Smart Cameras und ist Weltmarktführer bei ADSP Blackfin Core-Modulen.

Solutions umfasst die Anpassung vorhandener Embedded Systems und die Entwicklung neuer Hard- und Softwarelösungen. Abgedeckt werden dabei Projekt-Kooperationen und Langzeit-Support bis hin zu 'Blue Box'-Lösungen, in denen Bluetechnix die vollständige Entwicklung der Lösungen übernimmt.

Das unternehmenseigene, akkreditierte EMV-Laboratorium in Wien kann von Kunden zur EMV-Messung und -Zertifizierung genutzt werden, die dabei auf Wunsch teilweise oder vollständig von Bluetechnix durchgeführt werden kann.

Abgerundet wird dieses umfangreiche Angebot durch die langjährige Kooperation mit der Technischen Universität Wien und die enge Zusammenarbeit mit namhaften Partnerfirmen wie die Premiumpartnerschaft mit Analog Devices oder Freescale und garantiert so innovative Lösungen auf höchstem Qualitätsstandard innerhalb kurzer Entwicklungszeiten.

Anlage: Bild

